

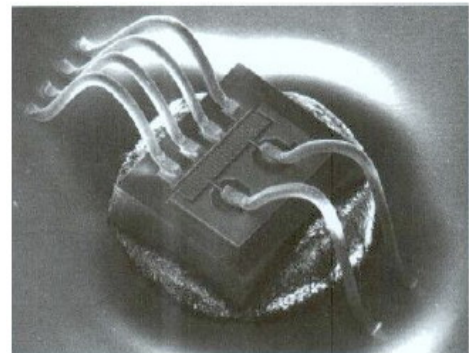
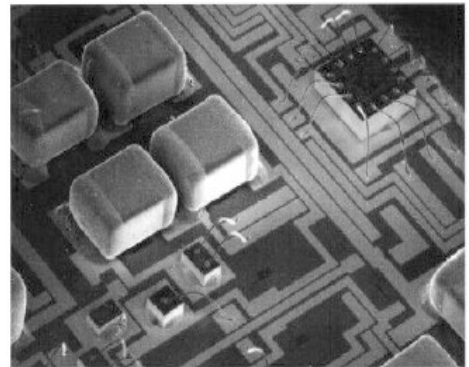
4523XDA1

手动深腔楔焊机



K&S 4523XAD1型深腔楔焊机，功能多样，具有万能生产能力,可创造出业界的最佳价值，支持混合电路,MCM多芯片模块、光学器件、微波器件、激光器件及分立器件等多种楔形焊接应用。

4523XDA1设计适用于铝线、金线及金带，功能多样，既可用于焊接简单的分立器件，也可焊复杂的混合型微波器件。焊头具备深腔焊接选项，并配备线尾调整系统，支持大深度微波空腔焊接。4523XDA1型焊接机能够使用直径18微米的超细焊线，可制作出射频装置需要的低弧度短线；配备有尼康或者奥林巴斯显微镜，可对焊接过程进行精密观察。本型焊接机在手动Z模式下工作时，操作人员可对弧度和焊线长度进行控制，非常适合于空间密集或者非常规弧线需要。4523XAD1型焊接机能够使用广泛的线径，并可对焊接参数和焊线弧度进行控制调整，是混合电路，MCM多芯片模块、光学器件、微波器件、激光器件及分立器件等多种楔形焊接应用的理想选择。



4523XDA1

手动深腔楔焊机

设备规格

XY Table

焊接区域	135 mm x 135 mm (5.3" x 5.3")
焊缝厚度	143 mm (5.6")
XY移动台行程粗调范围	140 mm (5.5")
XY移动台行程微调范围	14 mm (0.55")
鼠标变比	6:1
Z向运动系统	直流伺服/LVDT控制
Z向行程 (低复位)	6.6 mm (260密耳)
Z向行程 (高复位)	大于18 mm (710密耳)
超声波系统	高Q值60 kHz超声换能器 PLL锁相环超声波发生器 一焊、二焊分别控制

参数

超声波功率下限	1.3 W
超声波功率上限	2.5 W
焊接时间	10-100毫秒/10 - 1000毫秒
焊接压力 (不用弹簧)	压力线圈10 - 160克 焊头预紧力最大50克 一焊、二焊分别控制
进线角度	30°, 38°, 45° 可选90° 金带可选30°, 38°, 45°
温度控制器	最大250° C ± 5° C

处理能力

可焊线直径
金线: 18到76 μ m (0.7到3密耳)
铝线: 20到76 μ m (0.8到3密耳)
金带: 最大可选25×250um
(1×10密耳)

线轴: 标准: 1/2" 可选: 2"x1"

配套设施要求

电源
100 - 120/220 - 240V + 10%
50/60 Hz, 最大250 VA

尺寸
680 mm (27") 宽x700mm
(27.5") 深x 530mm (21") 高

重量 (基本型号)
装运重量: 55 kg (122磅)
净重: 31 kg (69磅)

